



中华人民共和国国家标准

GB/T 31469—2015

半导体材料切削液

Semiconductor materials cutting fluid

2015-05-15 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 技术要求	1
4 试验方法	2
5 检验规则	2
6 标志、包装、储存及运输	3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)提出并归口。

本标准起草单位:扬州华裕光伏材料有限公司、西安飞讯光电有限公司、扬州市职业大学、东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司、中国电子技术标准化研究院。

本标准起草人:缪德俊、徐蓉艳、缪立山、彭新玲、丁浩、郭倩、蒲学军、王香。

半导体材料切削液

1 范围

本标准规定了半导体材料切削液的各项技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存及运输等要求。

本标准适用于半导体材料线切割加工采用的切削液。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
- GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法(Hazen 单位——铂-钴色号)
- GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度的测定
- GB/T 6368 表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法
- GB/T 6678 化工产品采样总则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 10247 粘度测量方法
- GB/T 11275 表面活性剂 含水量的测定
- GB/T 11446.1 电子级水
- GB/T 12582 液态烃类电导率测定法
- GB/T 15346—2012 化学试剂 包装及标志

3 技术要求

半导体材料切削液技术要求应符合表 1 规定。

表 1 半导体及太阳能级晶体材料线切割用切削液要求

项目	要 求		
	I 型	II 型	III 型
外观	无色或微黄透明液体		
粘度 mPa·s(25℃)	≤40	40~52	≥52
密度 g/cm ³ (25℃)	1.103~1.118	1.113~1.126	1.118~1.130